



Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Presse](#) > **Pressemitteilungen**

Pressemitteilungen

Bayern begrüßt den Entwurf des European Chips Act 2.0

3. Juni 2026

MÜNCHEN / BRÜSSEL Die Europäische Kommission hat heute den Entwurf für den European Chips Act 2.0 (ECA 2.0) vorgestellt. Das Bayerische Wirtschaftsministerium begrüßt die geplante Weiterentwicklung des europäischen Halbleiterrahmens. Bayern hat sich im Rahmen der Konsultation in die Ausgestaltung des ECA 2.0 aktiv eingebracht.

„Der Entwurf des European Chips Act 2.0 enthält einige vielversprechende Elemente. Besonders begrüße ich die Weiterentwicklung des bislang strengen ‚First-of-a-Kind‘-Ansatzes, die explizite Berücksichtigung von Regionen sowie den erkennbaren Willen, Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren zu beschleunigen. Europa braucht mehr Tempo, wenn wir im globalen Wettbewerb bestehen wollen“, kommentiert Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. „Richtig und nachvollziehbar ist auch der Fokus auf die Schaffung zusätzlicher Nachfrage für innovative Halbleitertechnologien. Skeptisch sehe ich jedoch mögliche Vorgaben für die öffentliche Beschaffung. Entscheidend ist, dass wir Innovationen fördern, ohne neue Marktverzerrungen oder unnötige Bürokratie zu schaffen.“

Der Entwurf des European Chips Act 2.0 sieht schnellere Genehmigungsverfahren mit einer maximalen Dauer von 12 Monaten sowie die gezielte Förderung strategischer Halbleiterprojekte im Rahmen von „Grand Challenges“, insbesondere für KI-Anwendungen, vor. Zudem soll die Nachfrage nach europäischen Halbleitern gestärkt werden, unter anderem durch eine bessere Vernetzung von Herstellern und Anwenderindustrien, sogenannte „Demand Accelerators“, und eine stärkere Ausrichtung der öffentlichen Beschaffung auf europäische Technologien. Auf der Angebotsseite wird die Förderung von „First-of-a-Kind“-Projekten flexibler gestaltet und entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette erweitert. Ergänzt wird der Ansatz durch das neue Label „Semiconductor Regions of Excellence“, das leistungsfähige Halbleiterregionen sichtbar macht.

Mit Blick auf die vorgesehenen neuen europäischen Steuerungs- und Abstimmungsstrukturen mahnt Aiwanger zugleich eine schlanke und effiziente Umsetzung an: „Keinesfalls dürfen zusätzliche europäische Gremien und Abstimmungsstrukturen zu einem weiteren Aufbau bürokratischer Ebenen führen. Europa braucht mehr Handlungsfähigkeit, nicht mehr Verwaltungsaufwand. Wir werden den Vorschlag nun

sorgfältig analysieren und uns aktiv in die weiteren Beratungen einbringen – direkt in Brüssel ebenso wie als Gründungsmitglied der European Semiconductor Regions Alliance. Der globale Wettbewerb um Schlüsseltechnologien verschärft sich weiter. Deshalb müssen Brüssel und Berlin den European Chips Act 2.0 rasch auf den Weg bringen.“

Mit dem European Chips Act verfolgt die Europäische Union das Ziel, ihren Anteil an der weltweiten Halbleiterproduktion bis zum Jahr 2030 von derzeit rund zehn auf 20 Prozent zu steigern. Die im Jahr 2023 in Kraft getretene Verordnung hat wichtige Impulse gesetzt, die gesetzten Erwartungen jedoch bislang nicht vollständig erfüllen können. Vor diesem Hintergrund soll der European Chips Act 2.0 die europäischen Rahmenbedingungen für Forschung, Entwicklung, Produktion und Innovation im Halbleiterbereich weiter verbessern.

Halbleiter bilden die technologische Grundlage nahezu aller elektronischen Geräte und sind eine Schlüsseltechnologie für zahlreiche Zukunftsbranchen – von der Automobilindustrie über die Telekommunikation und Informationstechnologie bis hin zu Raumfahrt, Verteidigung sowie intelligenten und vernetzten Geräten. Ein leistungsfähiges Halbleiter-Ökosystem ist daher von zentraler Bedeutung für die technologische Souveränität Europas. Bayern hat daher im Herbst 2021 die [Bayerische Halbleiterinitiative](#) gestartet.

Ansprechpartnerin:

Franziska Wachtveitl

Stellv. Pressesprecherin

[Pressemitteilung auf der Seite des Herausgebers](#)

[Inhalt](#)

[Datenschutz](#)

[Impressum](#)

[Barrierefreiheit](#)

